



ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Digi International stellt die Produkte der nächsten Generation – darunter das neue DigiXbee3 – auf der Embedded World 2018 vor

Digi bringt branchenweit führende neue Produkte und realistische Demos zu einem IoT-Event der Spitzenklasse

MÜNCHEN, 12. Februar 2018 – Digi International®, (NASDAQ: DGII, www.digi.com), ein weltweit führender Anbieter von Konnektivätsprodukten und -dienstleistungen auf dem Gebiet des Internet of Things (IoT), gab heute bekannt, auf der [Embedded World 2018](#) die neue Digi® XBee3™ Serie von Smart Edge IoT-Modulen und Modems vorzustellen und eine Vorschau auf Digi ConnectCore® 8X zu präsentieren. Darüber hinaus wird Digi Vorführungen und Gesprächsrunden veranstalten, die die jüngsten Fortschritte bei den Embedded-Produkten und -Technologien verdeutlichen. Die Embedded World findet im Messezentrum Nürnberg zwischen dem 27. Februar und dem 1. März 2018 statt. Die Lösungen von Digi werden auf dem Stand von Digi vorgestellt, Halle A3, Stand 518.

Die Digi XBee3-Serie von HF-Modulen der nächsten Generation basiert auf einem unglaublich kleinen Mikroformfaktor und wurde entwickelt, um den Fortschritt der IoT-Innovationen am Rande des Netzwerkes zu unterstützen. Digi XBee3 bietet einen modularen Ansatz für die IoT-Konnektivität und bietet darüber hinaus die Programmierbarkeit mit MicroPython und Dual-Mode-Funkmodule mit der Möglichkeit, per Software auf Bluetooth LE aufzurüsten, wodurch Flexibilität beim drahtlosen Design, kostengünstige Integration und einfach hinzugefügte Funktionalität ermöglicht werden. Das Ergebnis sind innovative IoT-Lösungen, die schneller entwickelt, prototypisiert und in Serie produziert werden können.

Digi zeigt eine Vorschau der Digi ConnectCore 8X System-on-Module (SOM) und SBC. Digi ist Early Access Partner von NXP und das extrem kleine Modul wird die NXP i.MX 8X Prozessorfamilie nutzen, die auf ARM® Cortex®-A35 und Cortex-M4F Cores basiert. Die Verfügbarkeit des Entwicklungs-Kits ist aktuell für das dritte Quartal des Jahres 2018 geplant.

„Die Embedded World ist die ideale Veranstaltung, um diese innovativen Produkte den Fachleuten der IoT-Branche zu präsentieren“, sagte Mike Ueland, Senior Vice President von Digi International. „Mit Digi XBee3 haben wir ein Modul geliefert, das die Intelligenz und Flexibilität bietet, die für die nächste Generation von IoT-Anwendungen erforderlich sind,

und wir freuen uns darauf, seine Fähigkeiten und die unserer anderen Lösungen während dieser weltweit führenden Veranstaltung zu demonstrieren.“

Produktvorstellungen und Vorführungen

- **Digi XBee3 Serie** - Die Fähigkeiten der neu eingeführten DigiXbee3-Serie von Smart-Edge IoT-Modulen und Modems werden am Stand von Digi und bei ausgewählten Partnern vorgestellt. Der Digi XBee3 Mikroformfaktor hat nur ein Drittel der Größe des ursprünglichen Digi XBee HF-Moduls und ist mit 13 mm x 19 mm eines der kleinsten MicroPython-programmierbaren Module der Branche, das HF-Konnektivität für Anwendungen mit kurzer Reichweite und LPWAN bietet. Die Digi XBee3-Serie ist auch in den bestehenden Digi XBeeSMT und den Through-Hole-Formfaktoren verfügbar. Mit der Verringerung des Gewichtes, der Größe und des Stromverbrauchs ist Digi XBee3 ideal für kompakte und batteriebetriebene Anwendungen geeignet. Das Modul bietet eine mehrstufige Programmierbarkeit, die Fähigkeit, Intelligenz am Netzwerkrand zu liefern, und die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Protokollen zu wechseln, ohne das Gerät zu ersetzen.
- **Digi ConnectCore 8X Preview** – Digi zeigt eine Vorschau der Digi ConnectCore 8X System-on-Module und SBC auf seinem Stand. Unter Verwendung des zum Patent angemeldeten Formfaktors Digi SMTplus™ baut das extrem kleine Modul auf der kommenden NXP i.MX 8X-Prozessorfamilie auf, die auf ARM® Cortex®-A35- und Cortex-M4F-Kernen basiert, und bietet 802.11ac und Bluetooth Smart-Konnektivität, Grafik, Video, Bildverarbeitung, Audio/Voice-Fähigkeiten sowie Digi TrustFence®-Sicherheit für fortschrittliche IoT-Anwendungen in Bereichen wie Medizin/Gesundheitswesen, Transport, Gebäudeautomation, fortschrittliche HMI und der Industrie. Durch die Nutzung von Digis einzigartigem IoT-Know-how wird Digi ein branchenweites Konzept für vernetzte Systemlösungen für Gerätehersteller bereitstellen, die intelligente Edge-Produkte entwickeln. Digi wurde von NXP als Early Access Partner ausgewählt.
- **Digi XBee3 Cellular HVAC Demo** – Diese Demonstration zeigt, wie die eingebettete Programmierfähigkeit des Digi XBee3 Cellular Modems sowohl als Smart Edge Device als auch als Wireless Modem fungieren kann. Die HVAC-Demo wird veranschaulichen, wie das Digi XBee3 Cellular als lokaler Temperaturregler und drahtlose Kommunikationsschnittstelle funktioniert, und drei wichtige Technologieaspekte hervorheben, die für jede IoT-Anwendung von entscheidender Bedeutung sind, die Edge-Intelligenz nutzt: Edge-Intelligenz im Drahtlosmodul; autonome Edge-Kontrolle und die einfache Integration der Cloudschnittstellen von Drittanbietern.
- **Natural Disaster Relief Medical Response Center Demo** – Diese Demo verwendet Digi ConnectCore 6, Digi ConnectCore 6UL und Digi XBee3 Cellular Produkte, um ein System zu erreichen, das Notfall- und Feldkrankenhäusern die Möglichkeit bietet, die Vitaldaten von Patienten kontinuierlich zu überwachen und gegebenenfalls

Alarmmeldungen für schnelle Eingreiftruppen zu generieren. Es hilft bei der Eliminierung von Failure-to-Rescue-Ereignissen wie Tod oder Komplikationen, ermöglicht die zentrale Überwachung mehrerer Patienten und Standorte und ermöglicht die Aggregation und Analyse lokaler, regionaler und globaler Standortdaten, um Muster, Trends und Ergebnisse zu erkennen. Die Demo besteht aus drei Teilen: einem intelligenten Patientenknoten, der die Vitalparameter wie Temperatur, Herzfrequenz und Atemfrequenz überwacht; einem intelligenten Krankenhaus-Gateway, das Daten von den Knoten in die Cloud und EWS empfängt, verarbeitet und weiterleitet und gleichzeitig eine lokale Anzeigeoberfläche betreibt; und einer Cloud-Anwendung, die Sensordaten, EWS und Alarmstatus empfängt, in einer Datenbank speichert und verarbeitet und Ärzten und Pflegekräften Daten zur Verfügung stellt, bevor sie am Krankenbett des Patienten ankommen.

Lern-Sessions

- Am Dienstag, dem 27. Februar zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr, wird Mike Rohrmoser, Senior Director, Produktmarketing bei Digi International, als Teil der Session 6647 mit dem Titel „Auswahl der LPWAN Mobilfunktechnologie für das IoT“ referieren. Die Session befasst sich mit den Optionen bei der Auswahl des richtigen Mobilfunknetzes für Ihre IoT-Geräte und -Anwendungen durch die Einführung neuer Standards für LTE.
- Am Mittwoch, dem 28. Februar zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr, wird Alex Gonzales, Software Engineering Manager bei Digi, im Rahmen der Session 6632 „Yocto Project Linux als Plattform für die Entwicklung von Embedded Systems“ darüber sprechen, warum das Yocto-Projekt anstatt einer normalen, nicht für den Embedded Bereich optimierten Binärdistribution wie Debian oder Ubuntu verwendet werden könnte.
- Am Dienstag, dem 1. März um 13:00 Uhr, wird Digi eine Session mit dem Titel „Was sind die notwendigen Eigenschaften von intelligenten IoT-Geräten?“ vorstellen, die die Schlüsselemente eines intelligenten Endknotens definiert. Die Präsentation mit anschließender Diskussion findet am Stand des Digi-Partners Mouser, Halle 3, Stand 610, statt.

Mitaussteller und Partnerbeteiligung

Digi wird nicht nur auf dem eigenen Stand, sondern auch mit verschiedenen Partnern auf dem gesamten Messegelände IoT-Lösungen ausstellen, darunter Digi-Key Electronics (Halle 4A, Stand 633), Mouser (Halle 3, Stand 610), CODICO (Halle 3, Stand 310), Atlantik Elektronik (Halle 3, Stand 141), NXP Semiconductors (Halle 4A, Stand 220) und Silicon Labs (Halle 4A, Stand 4A).

• Vorführungen am Stand

- ConnectCore für i.MX6UL - In der interaktiven Demo werden die wichtigsten Funktionen des robusten ConnectCore für i.MX6UL SOM vorgestellt, darunter

Digi TrustFence®-Sicherheit, Ultra-Low-Power-Betrieb, Sensorintegration, Cloud-Konnektivität, Display-Integration und Benutzeroberflächenfunktionen.

- Digi XBee3 Cellular Produktdemo - Diese Demonstration zeigt, wie die eingebettete Programmierfähigkeit des Digi XBee3 Cellular Modems es ihm ermöglicht, sowohl als Smart Edge Device als auch als Wireless Modem zu fungieren. Die HVAC-Demo zeigt, wie das Digi XBee3 Cellular als lokaler Temperaturregler und drahtlose Kommunikationsschnittstelle fungiert.
- Digi XBee3 Cellular HVAC – Diese interaktive Demo mit dem Digi-Partner Silicon Labs veranschaulicht die sichere Cloud-Konnektivität über Digi XBee3 Cellular – es werden laufend von mehreren Standorten die Temperaturdaten protokolliert.

Über Digi International

Digi International (NASDAQ: DGII) ist ein weltweit führender Anbieter geschäftskritischer Machine to Machine (M2M) und Internet of Things (IoT) Verbindungslösungen und Dienstleistungen. Wir helfen unseren Kunden bei der Schaffung der nächsten Generation vernetzter Produkte und der Implementation und Verwaltung kritischer Kommunikationsinfrastrukturen in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Maß an Sicherheit, mit kompromissloser Verlässlichkeit und höchster Leistungsfähigkeit. Seit unserer Gründung im Jahr 1985 haben wir unseren Kunden bei der Verbindung von mehr als 100 Millionen Dingen geholfen und die Zahl wächst ständig. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Digi unter www.digi.com oder telefonisch unter 877-912-3444 (USA) oder 952-912-3444 (international).

Anmerkungen für Redakteure

Um ein Interview oder ein Produktbriefing mit einem Digi-Manager während der Embedded World 2018 zu vereinbaren, setzen Sie sich bitte mit Anthony Hildebrand oder John Waite unter Verwendung der nachfolgenden Angaben in Verbindung.

Pressekontakt:

Europa

Anthony Hildebrand oder John Waite

Catalyst For Content

Geschäftsstelle: +44 (0) 1753 648140

anthony@catalystforcontent.com, john@catalystforcontent.com

Nordamerika

Joseph Rigoli

LEWIS

Geschäftsstelle: +1 781-418-2400

Digi@teamlewis.com